

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第7部門第2区分  
 【発行日】平成23年12月8日(2011.12.8)

【公開番号】特開2010-135615(P2010-135615A)  
 【公開日】平成22年6月17日(2010.6.17)  
 【年通号数】公開・登録公報2010-024  
 【出願番号】特願2008-311050(P2008-311050)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/02 (2006.01)  
 H 0 1 L 23/06 (2006.01)  
 H 0 1 L 23/04 (2006.01)  
 H 0 1 R 9/16 (2006.01)  
 H 0 1 R 43/20 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/02 D  
 H 0 1 L 23/06 B  
 H 0 1 L 23/04 E  
 H 0 1 R 9/16 1 0 1  
 H 0 1 R 43/20 Z

【手続補正書】

【提出日】平成23年10月26日(2011.10.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

周辺の取付部位および中央の封着部位を有するステムベースと、このステムベースの封着部位にガラスで封着した貫通するリードとを具備し、前記リードと前記ステムベースを絶縁する気密端子において、前記ステムベースは耐熱ステンレス鋼を用いたことを特徴とする気密端子。

【請求項2】

前記ステムベースはS U S 3 1 0ステンレス材またはS U S 3 0 9ステンレス材のいずれかを用い、前記リードはF e - 5 0 % N i合金材を用いたことを特徴とする請求項1に記載の気密端子。

【請求項3】

封着に用いる前記ガラスはソーダバリウムガラス材を用いたことを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載の気密端子。

【請求項4】

周辺を取付部位と中央の封着部位を有するステムベースと、このステムベースの封着部位にガラスを介して貫通封着したF e N i合金材のリードとを具備する気密端子の製造方法において、S U S 3 1 0ステンレス材またはS U S 3 0 9ステンレス材のいずれかから選択した耐熱ステンレス鋼を成形加工により取付部位と封着部位を設けてステムベースを用意する工程、このステムベースの封着部位にガラスタブレットおよびリードを組立治具に配置し組立てる工程、次いで、この組立治具を加熱炉に通して前記ガラスタブレットを加熱溶解させる封着工程を含むことを特徴とする気密端子の製造方法。

【請求項5】

前記ガラスタブレットがソーダバリウムガラス材であり、前記封着工程は960 以上の窒素雰囲気炉で加熱処理することを特徴とする請求項4に記載の気密端子の製造方法。